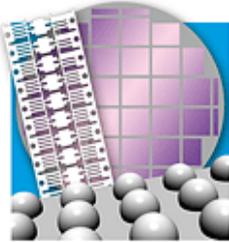


HYDRON SE 220

半导体电子专用 pH 值中性水基清洗剂



HYDRON® SE 220 是一款单相的水基清洗剂，专门设计用于浸没式清洗工艺中。

HYDRON® SE 220 能够有效去除包括引线框架、分立器件、功率模块、功率 LED、倒装芯片、摄像头模组等多种半导体电子器件上的助焊剂残留物。

HYDRON® SE 220 是一款单相清洗剂，提供卓越的工艺表现且易于漂洗，能够为后续的引线键合及成型等工艺提供理想的表面特性。

HYDRON® SE 220 是 pH 值中性的清洗剂，因此具有良好的材料兼容性。

应用领域： 半导体电子清洗应用 (引线框架，分立器件，功率模块，功率 LED，倒装芯片，CMOS)		本产品的更多信息：	
焊锡膏	低固型助焊剂残留物	+	技术信息 3： 材料兼容性概览
	水溶性助焊剂残留物	++	
	免洗型锡膏	++	
	高固态物助焊剂残留	++	
	含铅锡膏	+	

++ 强烈推荐, 效果最佳 + 推荐 0 可能 - 不推荐

ZESTRON 技术中心 - ① 美洲, ② 欧洲, ③ 马来西亚, ④ 上海-中国, ⑤ 深圳-中国
在生产条件下提供清洗工艺解决方案



关于免费清洗试验, 请咨询 ZESTRON 应用技术中心:

电话: +86-21-5296-8185; E-Mail: infochina@zestron.com

优点 (与其它清洗液相比):

- 由于其单相配方, HYDRON® SE 220 的应用过程十分简单, 在浸没式清洗工艺中提供卓越清洗表现。
- HYDRON® SE 220 能够被去离子水轻易漂洗干净, 不会在器件表面产生残留。
- HYDRON® SE 220 是一款 pH 中性清洗剂, 具有良好的材料兼容性, 特别是对于芯片, 其不会破坏芯片的钝化层。
- HYDRON® SE 220 能够为引线键合、成型、粘合剂键合等后续工艺提供洁净的铜表面, 并在一定时间内保持这些铜表面的活性。
- HYDRON® SE 220 没有闪点, 能够使用在浸没式清洗设备中, 且无需防爆保护。
- 产品配方中不含有卤素且气味极低。
- 清洗塑料前, 请参考材料兼容性表 (技术信息 3)

release date: 29.09.2014

技术信息 1

日本
神奈川县 - 日本
infojapan@zestron.com

北亚
上海/深圳 - 中国
infochina@zestron.com

南亚
Penang - 马来西亚
infoasia@zestron.com

美洲
Manassas, VA - 美国
infousa@zestron.com

欧洲
Ingolstadt - 德国
info@zestron.com

ZESTRON

清洗工艺	1. 清洗	2. 漂洗	3. 干燥
超声波 / 底部喷流	HYDRON® SE 220	去离子水 ¹	热风或循环风

¹去离子水的温度应为 20-40°C.

技术参数		
请注意: 本表中列出的数据, 采集自应用浓度为 25%的 HYDRON® SE 220		
密度	(g/ccm)在 20°C 时	0,99
表面张力	(mN/m)在 25°C 时	26,0
沸程	°C	>98
闪点	°C	无
pH 值	10g/l H ₂ O	中性
蒸气压	(mbar)在 20°C 时	约为 20
应用温度	°C	40 - 60
水溶性		可溶的
应用浓度 ¹	%	20-25%
HMIS 级别	健康性-可燃性-反应活性	1 - 0 - 0

¹HYDRON® SE 220 必须在去离子水中稀释

产品特点



经过广泛的测试, 本产品适用于去除无铅锡焊膏的残留物



本产品不含有 SIN 和 SVHC 清单中列出的任何危险物质



本产品完全符合欧盟的各项法规(RoHS 1 & 2, WEEE)

过滤系统建议:

- 为了最大限度地发挥该产品的优势并进一步延长 HYDRON® SE 220 的使用寿命, 推荐使用循环过滤系统。

环保、健康及安全法规:

- HYDRON® SE 220 是可以生物降解的水基清洗剂;
- HYDRON® SE 220 安全环保, 不含任何卤素成分;
 - 具体的操作注意事项和处置措施, 请参考本产品的 MSDS 文件;

包装/存储:

- HYDRON® SE 220 提供浓缩液包装, 包括 1 升瓶装, 5 升或 25 升罐装及 200 升桶装
- 建议将该产品储存在 5°C - 30°C 温度环境下的原始包装中
- 在工厂密封包装的条件下, 本产品的有效期至少为 5 年